

2021年9月28日

各 位

会 社 名 宇部エクシモ株式会社
本社所在地 東京都中央区日本橋富沢町9番19号
問 合 せ 先 総務部長 佐藤 治彦
Tel 03-6667-2411

「エクシラム®シリーズ」高周波基板材料向け CCL の開発について

宇部エクシモ株式会社（社長：高橋俊充）は、販売する無接着剤タイプの銅張積層板「エクシラム®シリーズ」に、新たに高周波基板材料向け CCL を開発し、今後売上の拡大を目指す。

2019年以降各国で第5世代移動通信システム（以下、5G）の本格導入が進み、日本国内においても昨年3月から5Gの商用サービスが開始された。また、クラウド化の進展に伴い、ビッグデータを扱う有線高速通信設備への投資も活発化している。

そのような背景から、各素材メーカーでは様々な低誘電材料の開発・提案を活発化しており、液晶ポリマー(LCP)やモディファイドポリイミドなどの採用例が増えてきている。

宇部エクシモでは、独自の高温かつ均一に圧力をかけることのできる高度なラミネート技術を用いてお客様の多様なニーズに応える製品の開発に取り組んでいるが、この度、AGC株式会社のフッ素樹脂「Fluon™ EA-2000」を使用した銅張積層板（FCCL）の開発に成功した。このFCCLはこれまでのポリイミド及びLCPベースのFCCLに比べ、非常に低い伝送損失を実現しており、且つ剥離強度は密着力に課題のあるLCPなどの低誘電材料を用いたFCCLと比較し優位な結果が得られている。宇部エクシモでは、圧延、電解銅箔グレードとともにラインナップし、今後顧客のニーズに応じてきめ細かい提案をしていく。

フッ素樹脂を用いたFCCLは不燃性で、誘電特性が最高クラスであるため、5Gの本格導入により市場の拡大が進む基地局や車載ミリ波レーダーなどの高周波プリント基板への採用が期待できる。宇部エクシモではサンプル出荷を順次進め、2022年度中の上市を目指し今後も開発を加速する。



「エクシラムシリーズ」